

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1-1	แผนการดำเนินงาน	6
2-1	แนวทางการให้คะแนน หมวด 1 – 6	16
2-2	แนวทางการให้คะแนน หมวด 7	18
2-3	แสดงลักษณะของใบตรวจสอบ	33
2-4	แสดงประเภทของกราฟชนิดต่างๆ	35
2-5	แสดงลักษณะต่างๆ ของฮิสโตแกรม	36
2-6	แสดงขั้นตอนและสัญลักษณ์ของแผนภูมิกระบวนการ	41
3-1	การวิเคราะห์ช่องว่างในหมวด 6.1ก) ความสามารถพิเศษ	51
3-2	การวิเคราะห์ช่องว่างในหมวด 6.1ข) การออกแบบกระบวนการทำงาน	53
3-3	การวิเคราะห์ช่องว่างในหมวด 6.1ค) ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน	54
3-4	การวิเคราะห์ช่องว่างในหมวด 6.2ก) การจัดการกระบวนการทำงาน	55
3-5	การวิเคราะห์ช่องว่างในหมวด 6.2ข) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน	56
3-6	สรุปผลการใช้วัดคุณภาพระหว่างเดือน ตุลาคม 2550 ถึงเดือน มีนาคม 2551	58
3-7	แสดงผลการใช้วัดคุณภาพและต้นทุนส่วนเพิ่ม	59
3-8	แสดงสาเหตุการสูญเสียและต้นทุนสะสม	61
3-9	ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนของกระบวนการ Type Change	65
3-10	ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนของกระบวนการตั้งค่าเครื่องจักร	65
3-11	แสดงการจำแนกปัญหาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง	67
3-12	แสดงแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดปัญหาการทิ้ง Lead frame...	69
4-1	แสดงทางเลือกในการหาวัสดุทดแทน	75
4-2	ผลการทดสอบหาอายุการใช้งาน Lead frame เคลือบฟิล์ม	92
4-3	ผลทดสอบการกระจายตัวของ AG Paste	84
4-4	แสดงผลการวัดค่าการเยื้องในแนวแกน X-Y (X-Y Dislocation)	85
4-5	แสดงผลการวัดค่า Die Shear	87
4-6	แสดงปริมาณการทิ้ง lead frame แยกประเภทก่อนและหลังการปรับปรุง	89
4-7	แสดงปริมาณการทิ้ง lead frame ก่อนและหลังการปรับปรุง	90

4-8	เปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นต่อหน่วยจากการทิ้ง Lead Frame ก่อนและหลัง การปรับปรุง	92
5-1	สรุปผลการการสูญเสีย lead frame ที่กระบวนการผลิต Die Bond.....	97
5-2	สรุปผลการลดต้นทุนการสูญเสียต่อชิ้นงานแผงวงจรรวมที่เกิดจาก การสูญเสีย lead frame ที่กระบวนการผลิต Die Bond	98